

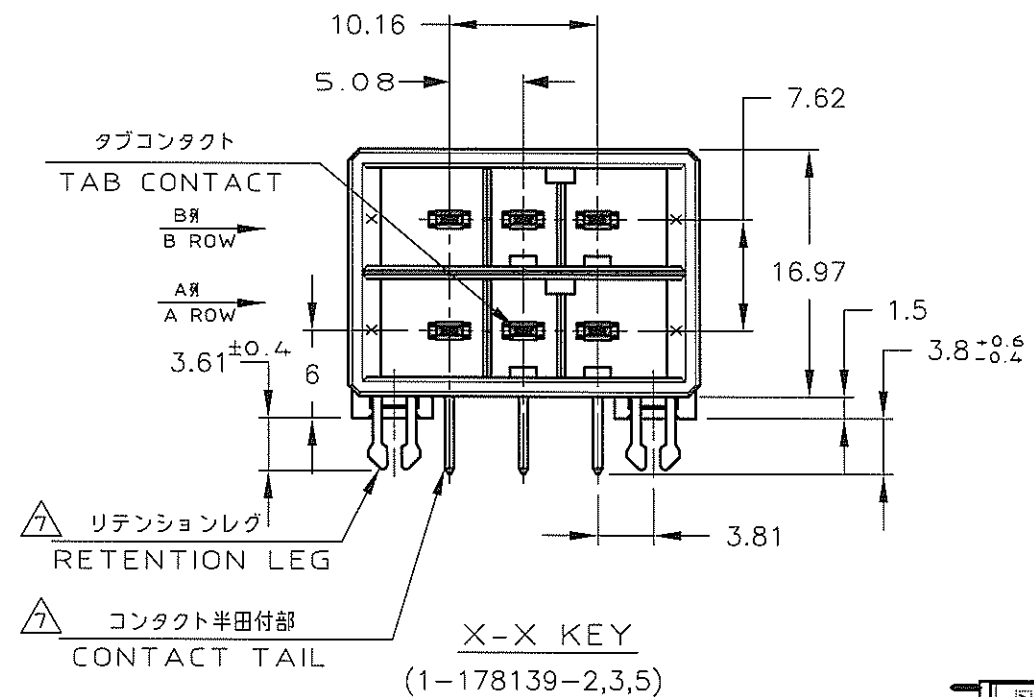
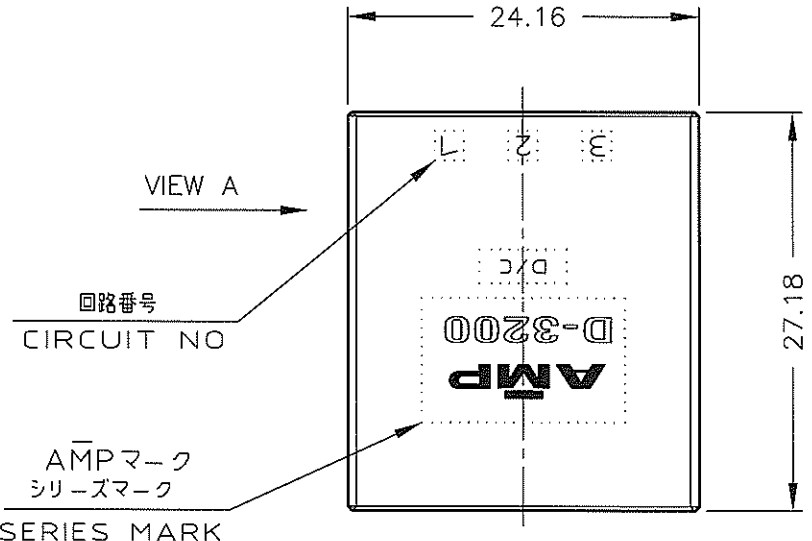
NUMBER 178139

3rd ANGLE PROJECTION

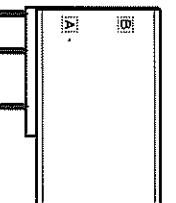
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

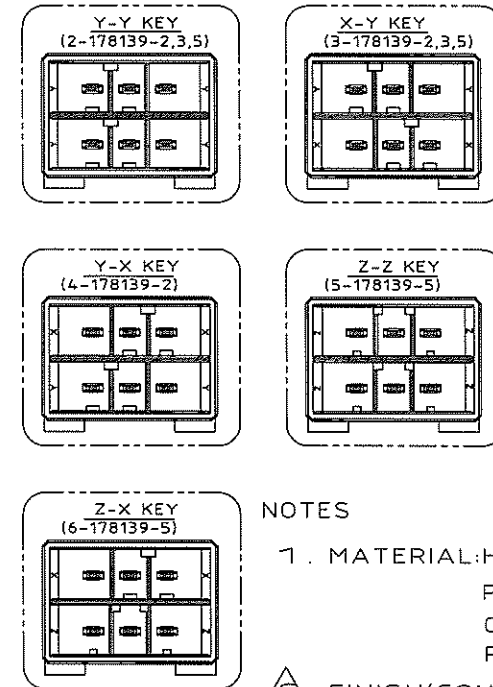
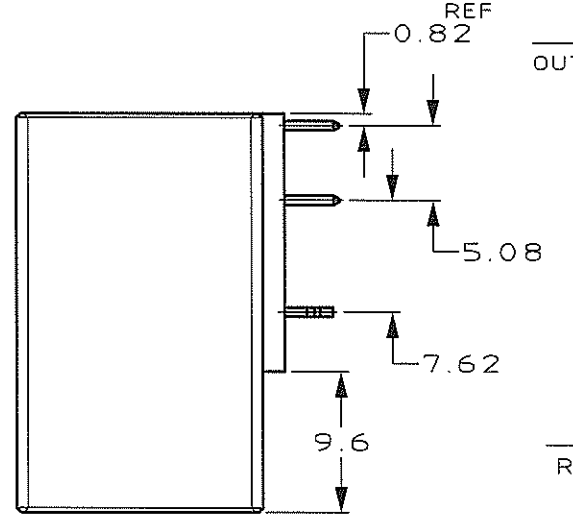
PRINT DIST



△ 4	△ 2	1,2,3,5,6-178139-5
△ 3	△ 1	1,2,3-178139-3
△ 2	△ 1	1,2,3,4-178139-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

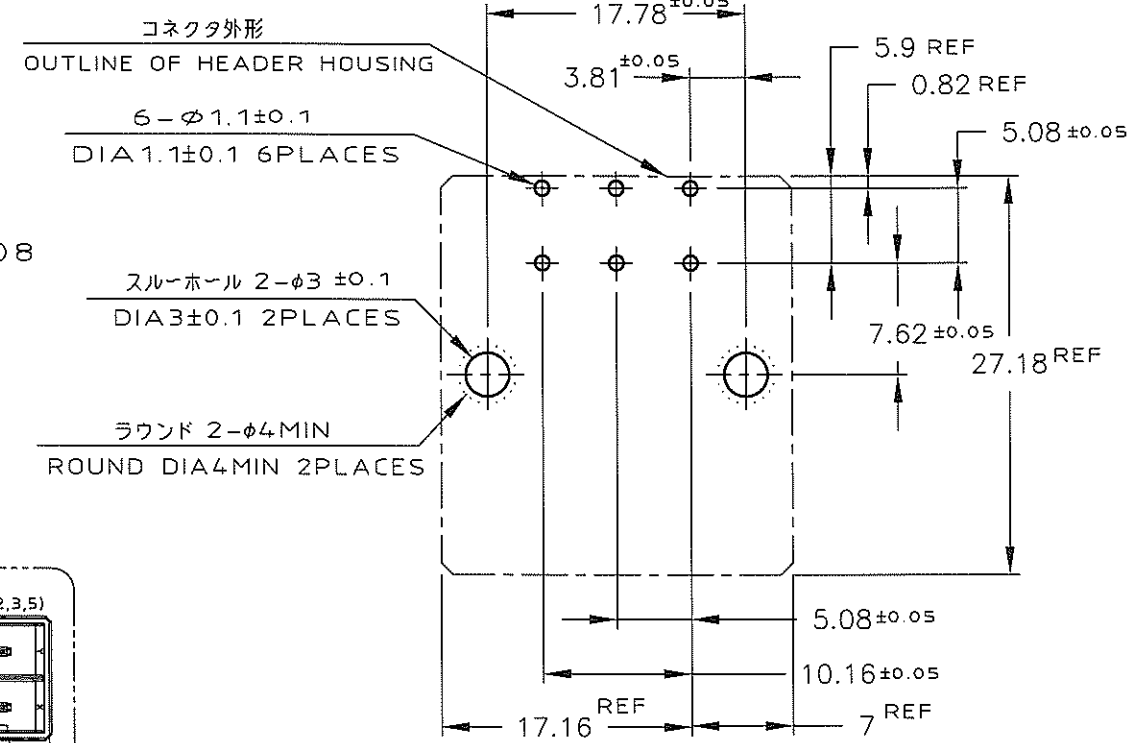


VIEW A
(SCALE:1:1)



NOTES

- MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:CU-PALLOY
RETENTION LEG:CU-PALLOY
- FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH(RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- PRODUCT SPEC: 108-5349
- FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL




推奨基板取付け寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- 製品規格: 108-5349
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

								 TE Connectivity			
				WIRE RANGE mm ² (AWG -)		INSULATION DIA - mmφ		NAME 6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200			
				MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照					
E3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14APR 11	DR. 20/MAR/'95 K.IKEDA	DE. 20/MAR/'95 K.IKEDA	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10±F : ±0.3 100±F 300±F : ±0.4 300±F 1000±F : ±0.4,5 A 度 : ±3'		SIZE A3	LOC J	NUMBER C-178139
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK. 23/MAR/'95 S.MANABE	APP. 23/MAR/'95 S.MANABE	SCALE 2-1		REV. E3	SHEET 1 OF 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-178139-5](#)